

製品・技術 PR レポート

1. 企業概要

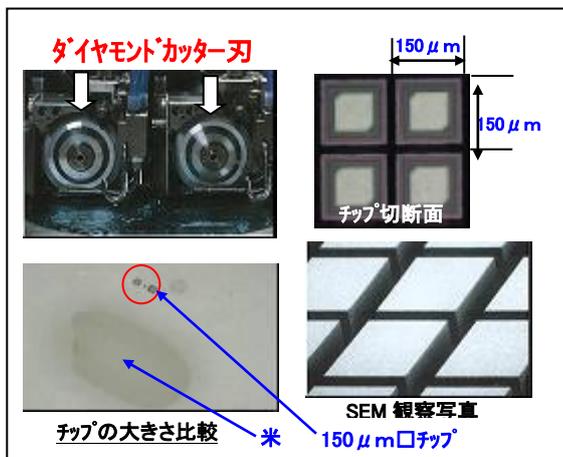
会社名	株式会社 塩山製作所	代表者名	松坂 浩志		
		窓口担当	佐藤 孝志		
事業内容	Si 化合物ウェハの溝入れ切断加工 ウェハ研削から裏面金属加工 RF-ID 製品のシステム販売	URL	http://www.enzan.com		
主要製品	Si ウェハ、GaAs ウェハ、InP ウェハ、電子材料の加工、RF-ID システムの販売				
住所	山梨県甲州市塩山下於曾 276				
電話/FAX番号	0553-33-3136 / 0553-32-1152	E-mail	info@enzan.com		
資本金(百万円)	40	設立年月日	昭和59年4月	売上(百万円)	130
				従業員数	65

2. PR事項

半導体、電子材料の研磨、切断は専門メーカーの塩山製作所にお任せを!!
他の加工メーカーで対応できないものもご相談を!!

当社は半導体ウェハ、セラミック、電子材料等をより薄く、より小さく加工することを得意とする研磨、切断加工の専門メーカーです。研磨では 30 ミクロンまでの厚さ、切断サイズとしては 150 ミクロン角まで安定した加工製品を提供できます。また脆性材、難研削材の加工も、当社独自のノウハウで安定した生産ができます。さらに、加工した非常に小さい IC チップを使ったシステムとして、RF-ID での固体認証を管理するアプリケーションの開発と製品化を実現しました。

超小型半導体チップの加工事例



裏面研削、研磨作業

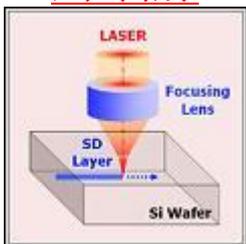


RF-ID システム例

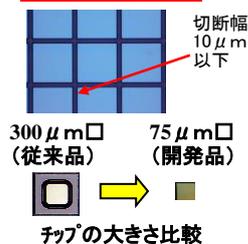


システム実用例:
在庫管理、図書貸出し管理、
制服管理、倉庫管理、宝石管理、
入門管理、工程管理など

レーザーダイシング



プラズマによる切断



3. 特記事項

H21 年度 ものづくり中小企業製品開発等支援事業補助金に採択されました。
H21 年度 やまなし産業支援機構の『研究開発助成事業』に採択されました。
H19 年度 経済産業省『戦略的基盤技術高度化支援事業』に採択されました。
H18 年度 やまなし産業支援機構の『研究開発助成事業』に採択されました。